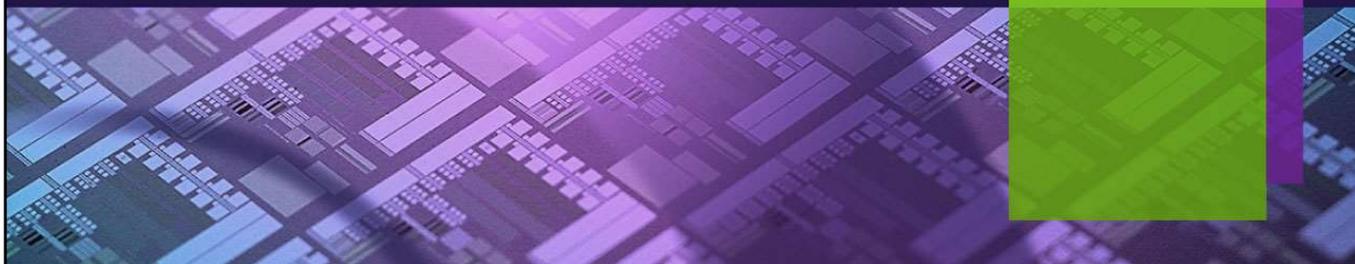


2025年3月期 第1四半期（2024年4月～6月） 東京エレクトロン 決算説明会

2024年8月8日

内容：

- 連結決算の概要 川本 弘 （常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー）
- 事業環境および業績予想 河合 利樹 （代表取締役社長・CEO）



将来予想等に関する記述

- 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の事業計画、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、政治経済情勢、半導体市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権、新型コロナウイルス感染症の影響など、さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

- 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

- 為替リスクについて

当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、極端な為替レートの変動がない限りにおいては、利益への影響は軽微です。

第1四半期 連結決算の概要

2024年8月8日

常務執行役員 ファイナンス本部 ディビジョンオフィサー
川本 弘



川本でございます。私から、2025年3月期第1四半期連結決算の概要をご説明いたします。

損益状況（四半期）

(億円)

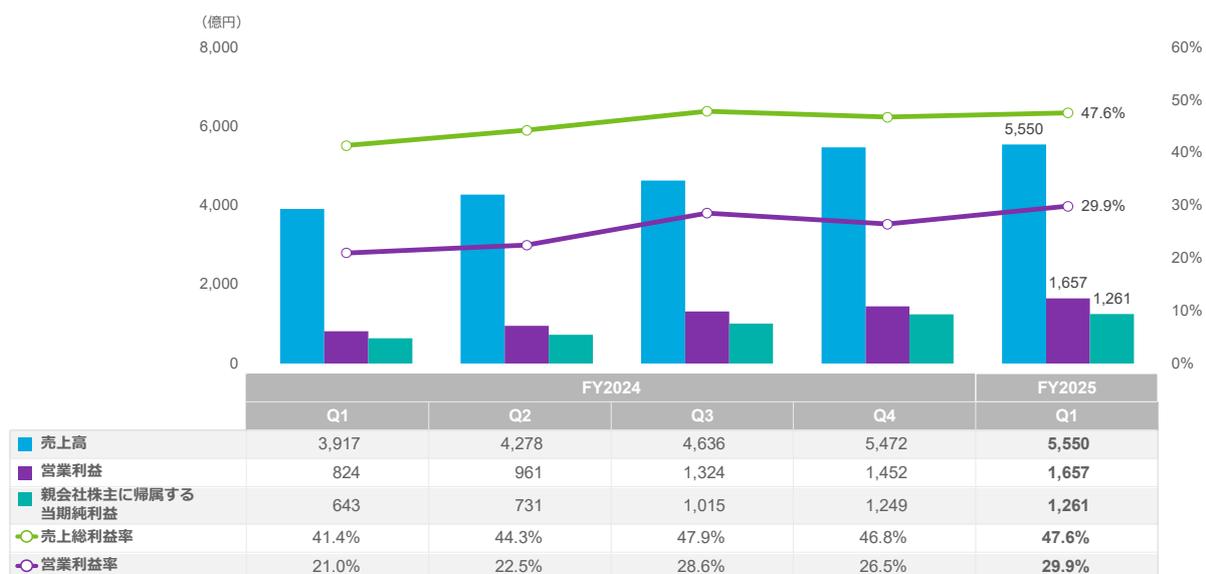
	FY2024				FY2025	vs. Q4 FY2024	vs. Q1 FY2024
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1		
売上高	3,917	4,278	4,636	5,472	5,550	+1.4%	+41.7%
売上総利益	1,623	1,897	2,221	2,561	2,640	+3.1%	+62.7%
売上総利益率	41.4%	44.3%	47.9%	46.8%	47.6%	+0.8pts	+6.2pts
販管費	798	935	896	1,108	982	-11.4%	+23.0%
営業利益	824	961	1,324	1,452	1,657	+14.1%	+101.1%
営業利益率	21.0%	22.5%	28.6%	26.5%	29.9%	+3.4pts	+8.9pts
税金等調整前当期純利益	830	981	1,344	1,578	1,672	+5.9%	+101.5%
親会社株主に帰属する当期純利益	643	731	1,015	1,249	1,261	+1.0%	+96.2%
研究開発費	436	510	497	584	534	-8.5%	+22.4%
設備投資額	393	176	318	329	239	-27.2%	-39.1%
減価償却費	106	125	138	153	132	-14.0%	+24.5%

1. 当社製品の輸出売上は、原則円建てでおこなわれます。一部に外貨建売上および費用計上もありますが、為替レート変動による利益への影響は極めて軽微です。

2. 利益率および増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

こちらは、四半期毎の「損益状況」になります。青枠の部分を中心にご覧ください。第1四半期の売上高は、前四半期比 1.4%増加の 5,550億円となりました。売上総利益は、3.1%増加の2,640億円。売上総利益率は、プロダクトミックスの改善と、在庫処理などの一過性要因がなかったため、0.8ポイント増加の47.6%となりました。営業利益は、前四半期比14.1%増加の、1,657億円。営業利益率は売上総利益率の増加、研究開発費を含む、販管費比率の減少により、前四半期比3.4ポイント増加の29.9%と高い水準となりました。税金等調整前当期純利益は、5.9%増加の1,672億円、また、親会社株主に帰属する当期純利益は、前四半期比 1.0%増加の 1,261億円となりました。

損益状況（四半期）



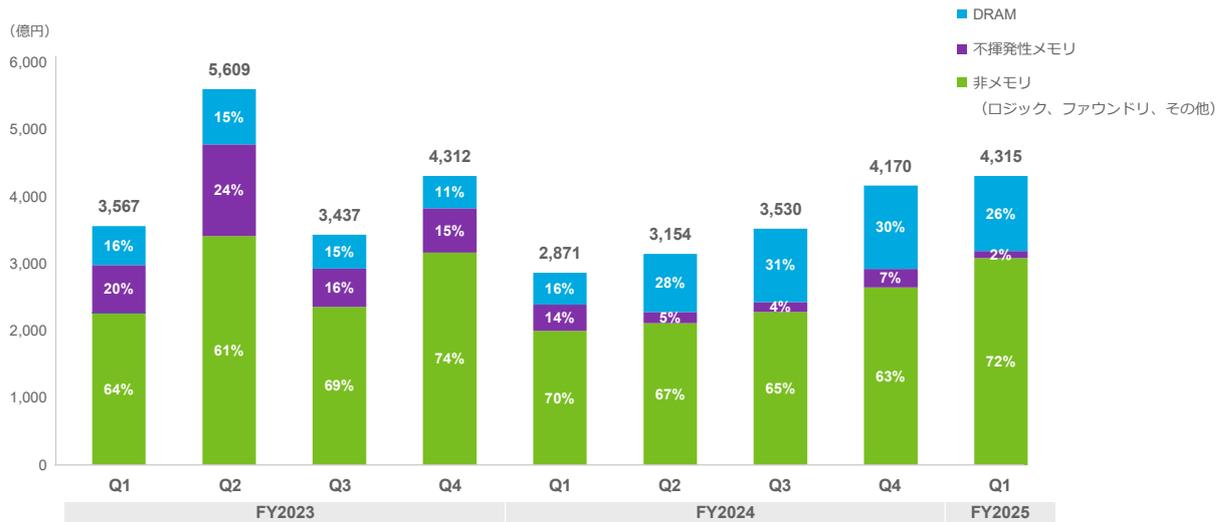
Investor Relations / August 8, 2024

TEL

5

こちらは、先ほどご説明させていただいた業績を時系列でグラフで示したものになります。売上高、利益率ともに、徐々に改善していることがお判りいただけるかと思えます。

SPE新規装置 アプリケーション別売上構成比（四半期）

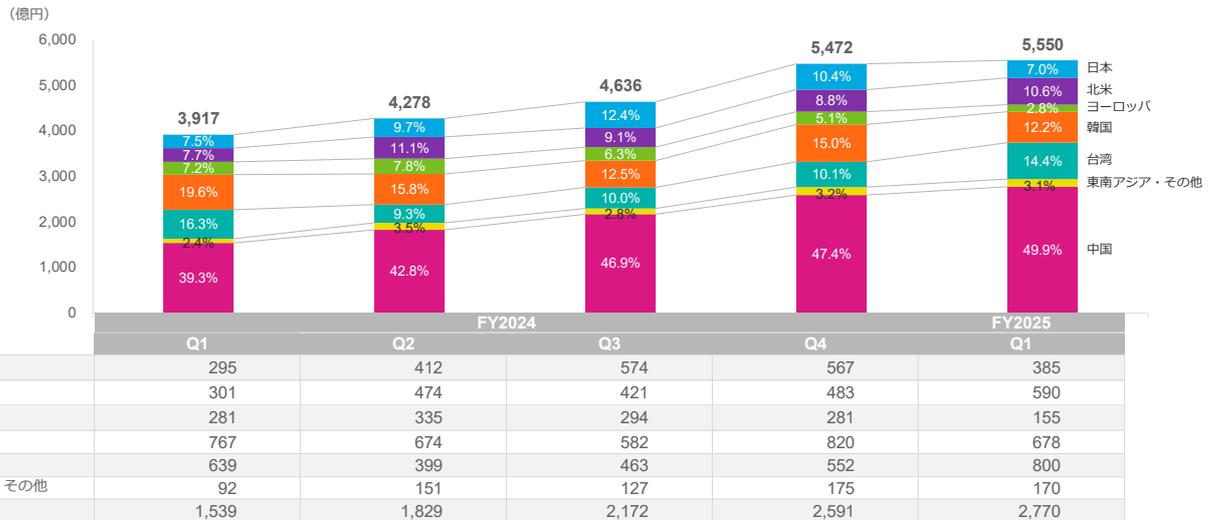


*1 SPE：半導体製造装置

*2 グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューションの売上高は含まれていません。

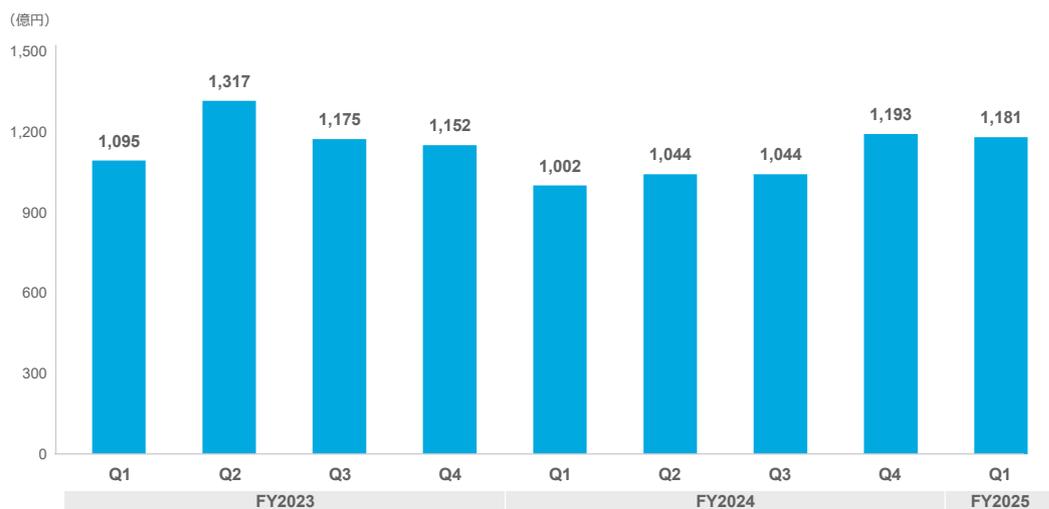
こちらは、「SPE新規装置のアプリケーション別 売上構成比」になります。第1四半期は、下から非メモリ 72%、不揮発性メモリ 2%、DRAM 26%となりました。前四半期と比較すると、DRAMと不揮発性メモリの売上高、構成比は低下、非メモリの売上高、構成比は上昇いたしました。

地域別売上高構成比（FY2024 Q1～FY2025 Q1）



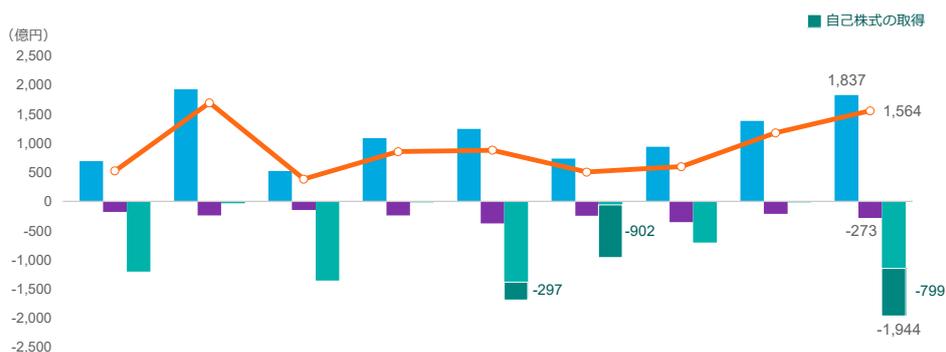
こちらは、「地域別売上高」になります。第1四半期の地域別売上高は、アプリケーション別売上高構成比でもご説明したとおり、主に、非メモリの売上高が上昇し、前四半期と比較して、構成比は特に台湾で増加し、北米、中国においても増加いたしました。

フィールドソリューション売上高（四半期）



こちらは、「フィールドソリューション売上高」になります。第1四半期は12億円減少の、1,181億円となりました。中古・改造案件が主に減少する一方、パーツ・サービス売上は、顧客稼働率改善に伴い、増加いたしました。

キャッシュ・フロー（四半期）



	FY2023				FY2024				FY2025
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
■ 営業キャッシュ・フロー	699	1,934	532	1,096	1,257	748	950	1,390	1,837
■ 投資キャッシュ・フロー ^{*1}	-166	-231	-138	-231	-368	-234	-344	-203	-273
■ 財務キャッシュ・フロー	-1,191	-21	-1,346	-5	-1,641	-908	-693	-6	-1,944
○ フリーキャッシュ・フロー ^{*2}	533	1,702	393	865	888	514	606	1,187	1,564
手元資金残高 ^{*3}	3,146	4,846	3,874	4,731	4,010	3,626	3,524	4,725	4,385

*1 投資キャッシュ・フローは、定期預金および短期投資の増減を除いた金額です。

*2 フリーキャッシュ・フロー = 営業キャッシュ・フロー + 投資キャッシュ・フロー（定期預金および短期投資の増減を除く）

*3 手元資金は、現金及び現金同等物と満期日または償還日までの期間が3か月を超える定期預金および短期投資の合計額です。

Investor Relations / August 8, 2024

続きまして、「キャッシュ・フロー」になります。この四半期における営業キャッシュフロー獲得は、1,837億円ございました。投資キャッシュフローの支出は、273億円。財務キャッシュフローの支出は、自己株式の取得799億円を行い、1,944億円。なお、フリーキャッシュフローは、1,564億円となりました。

自己株式の取得状況

- 2024年6月30日までに取得終了
 - 取得した株式の総数 2,317,000 株
 - 株式の取得価額の総額 79,998,958,000 円

- ご参考（2024年5月10日開催 取締役会決議内容）
 - 取得対象株式の種類 当社普通株式
 - 取得し得る株式の総数 350 万株（上限）
（自己株式を除く発行済株式総数に対する割合0.8%）
 - 株式の取得価額の総額 800 億円（上限）
 - 取得する期間 2024年5月13日～2024年7月31日

最後に、「自己株式の取得状況」をお伝えいたします。2024年6月30日をもちまして、5月10日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得は終了いたしました。2024年5月から6月末にかけて取得した株式の総数は、231万7,000株、株式の取得額の総額は、799億円となりました。以上、2025年3月期 第1四半期「連結決算の概要」をご報告いたしました。

事業環境および業績予想

2024年8月8日

代表取締役社長・CEO
河合 利樹



河合でございます。「事業環境 および 業績予想」について、ご説明いたします。

事業環境（2024年8月時点でのWFE市場の見方）

■ CY2024：\$100B強と予測

- 旺盛なAIサーバー向け投資。PC・スマートフォン向けの稼働率も着実に回復基調へ
 - DDR5やHBM^{*1}等の需要増によるDRAM向けの投資が活況
 - 最先端ロジック/ファウンドリにおいては、前工程装置のみならず、パッケージングやテストのニーズも急増

■ CY2025：二桁成長を期待

- 好調なAIサーバーに加え、PC・スマートフォンのAI搭載比率上昇を見込む
 - DRAMのさらなる拡大に加え、NANDも在庫調整が進捗し投資再開
 - 先端ロジック/ファウンドリ向けの設備投資も増加し、成熟向け投資の一服感をオフセット

➔大容量・超高速・低消費電力の実現に向けた技術革新が進展

GAA^{*2}、Backside PDN^{*3}、HBM、三次元実装におけるテスト工程（ウェーハプローバ）など、TELのビジネス機会は拡大

^{*1} HBM（High Bandwidth Memory）

：高帯域幅DRAM

^{*2} GAA（Gate All Around）

：トランジスタのチャネル全面をゲートで覆った構造

^{*3} Backside PDN（Power Delivery Network）

：電源供給配線をシリコンの裏面に配置する構造

まず、「事業環境」について、ご説明します。CY2024のWFE市場は、一部、お客様の投資計画に変更があるものの、全体としては、増加傾向にあります。足元では、旺盛なAIサーバー向け投資が続いており、PC、スマートフォン向けの稼働率も着実に回復基調にあります。これに伴い、DDR5やHBMなどの需要増によりDRAM向け投資が加速しています。また、先端ロジック/ファウンドリにおいては、前工程のみならず、アドバンスドパッケージングやテストのニーズも急拡大しています。CY2025には、好調なAIサーバーに加えて、PC・スマートフォンのAI搭載比率が上昇すると見込まれます。先行するDRAMに加えて、NANDも在庫調整が進捗し、投資の再開が期待されます。また、先端ロジック/ファウンドリの設備投資も本格回復し、成熟向け投資の一服感をオフセットすると予測しています。これらを背景に、CY2025のWFEは、二桁成長になると期待しています。AI用途には、最先端の半導体技術が求められます。大容量、超高速、低消費電力の半導体デバイスの実現に向け、技術革新が進展します。GAA、Backside PDN、高積層メモリなどの技術進化に伴い、当社のビジネス機会はますます拡大していきます。

FY2025 Q1 事業進捗

- 売上・利益ともに計画を上回る
 - 売上5,550億円、営業利益1,657億円、営業利益率29.9%
- 戦略製品によるPOR*獲得・開発評価も順調
 - DRAM向けコンダクターエッチング、最先端ロジック向け洗浄装置で開発POR獲得
 - NAND向け極低温エッチング、ボンディングなど、量産に向けた開発・評価が着実に進捗
- 先端パッケージングやテストの引き合い急増
 - 塗布現像、エッチング、バッチ成膜、ボンディング、ウェーハローバ等、幅広くリクエストあり
- 半導体の技術革新に貢献する新製品をリリース
 - 枚葉成膜装置「Episode™シリーズ」：微細化や3次元化、成膜材料の多様化のニーズに対応
 - ガスクラスタービーム装置「Acrevia™」：
低ダメージで極微細な線幅加工と形状補正をおこなう。EUVパターニング工程のコストを低減
- 約800億円の自己株式取得を完了

* POR (Process of Record) : 顧客の半導体製造プロセスにおける装置採用の認定

Investor Relations / August 8, 2024

TEL 14

次に、「FY2025 第1四半期の事業進捗」についてご説明します。業績については、先ほど川本から説明しました通り、売上・利益ともに計画を上回り着地しました。付加価値の高い戦略製品で、PORを順調に獲得しております。DRAM向けコンダクターエッチング、最先端ロジック向け洗浄装置で開発PORを獲得したほか、戦略製品である、極低温エッチングや、今後ますます拡大が期待されるボンディングでも、量産に向けた開発・評価が着実に進捗しております。足元で急拡大している、パッケージングやテストのニーズを捉え、塗布現像、エッチング、バッチ成膜、ボンディング、ウェーハローバ等、大変多くの引き合いを頂いております。

また、7月のSEMICON Westのタイミングに合わせて、最先端技術を搭載した新製品をリリースしました枚葉成膜装置「Episode™シリーズ」は、微細化や3次元化、成膜材料の多様化などのニーズに応えるべく、幅広い装置ラインナップを展開します。「Episode™1」は、最先端ロジックの金属配線の接触抵抗を低減。

「Episode™2」は、2枚葉、4枚葉タイプがあり、高品質な成膜を高い生産性で実現します。ガスクラスタービーム装置「Acrevia™」は、低ダメージで微細な線幅加工と形状補正を行い、EUVパターニング工程のコスト低減に貢献します。これらの装置は、既に複数のお客様への納入・評価が始まっており、FY2027の中期経営計画の売上・利益目標の達成に向けた貢献が期待できます。なお、5月に発表した、約800億円の自己株式の取得は完了しました。

FY2025 業績予想

次に、「FY2025の業績予想」について説明致します。

FY2025 業績予想

(億円)

	FY2024 (実績)	FY2025 (新予想)				
		H1	H2	通期	通期 修正額	通期 対前期増減
売上高	18,305	11,000	12,000	23,000	+1,000	+25.6%
売上総利益	8,302	5,040	5,680	10,720	+500	+29.1%
売上総利益率	45.4%	45.8%	47.3%	46.6%	+0.1pts	+1.2pts
販管費	3,740	2,160	2,290	4,450	+50	+19.0%
研究開発費	2,028	1,210	1,320	2,530	+30	+24.8%
研究開発費以外の販管費	1,711	950	970	1,920	+20	+12.2%
営業利益	4,562	2,880	3,390	6,270	+450	+37.4%
営業利益率	24.9%	26.2%	28.3%	27.3%	+0.8pts	+2.4pts
税金等調整前当期純利益	4,734	2,900	3,400	6,300	+460	+33.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	3,639	2,180	2,600	4,780	+330	+31.3%
1株当たり当期純利益 (円)	783.75	472.61	-	1,036.94	+75.75	+253.19

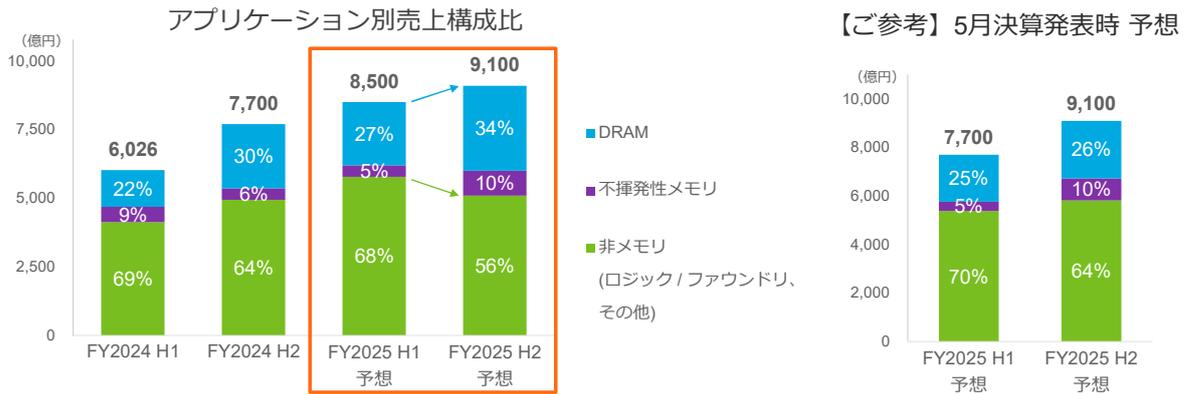
Q1実績および最新の市場動向を反映し、業績予想を上方修正。
 FY2025は過去最高の売上高、売上総利益、売上総利益率、営業利益、
 当期純利益およびEPSを見込む

Investor Relations / August 8, 2024

TEL 16

先程ご説明させていただきました通り、AI関連機器の需要に牽引され、WFE市場は現在回復基調にあり、CY2025に向けて、最先端メモリ、最先端ロジックの設備投資が本格化すると期待されます。第1四半期の実績および最新の市場動向を反映し、業績予想を上方修正します。FY2025は、通期で、売上高2兆3,000億円、売上総利益1兆720億円、営業利益6,270億円、当期純利益4,780億円となります。また、将来の成長機会を最大限取り込むため、今期は2,530億円の研究開発投資を予定しております。売上高、売上総利益および売上総利益率、営業利益、当期純利益およびEPSは、過去最高になる見込みです。

FY2025 SPE新規装置売上予想



グラフは新規装置の売上高における構成比を示しています。フィールドソリューション売上高は含まれていません。

最新の市場動向を反映し、メモリとロジックの売上比率を修正

こちらは、「FY2025のSPE 新規装置の売上予想」です。ご覧のとおり、前上期を底に、売上は回復基調です。最新の市場動向を反映し、メモリとロジックの売上比率を修正いたします。

FY2025 研究開発費・設備投資計画

新開発棟
成膜装置、エッチング装置、コーポレート開発



山梨県韮崎市
2023年7月 竣工

東北生産・物流センター
成膜装置



岩手県奥州市
2025年秋 竣工予定

新開発棟
コート/デベロッパ、洗浄装置、ボンディング装置

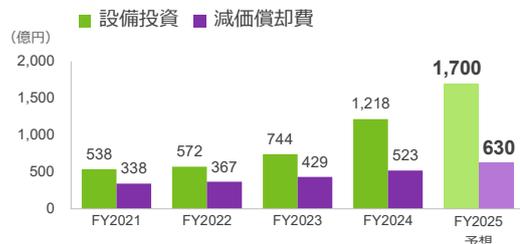


熊本県合志市
2025年夏 竣工予定

新開発棟
エッチング装置



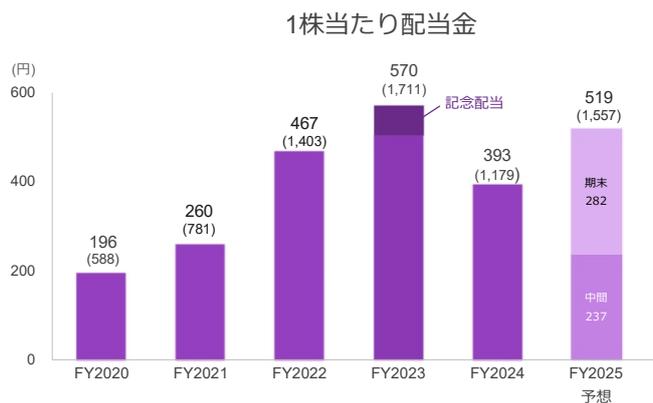
宮城県黒川郡
2025年春 竣工予定



さらなる成長を見据え、積極的な研究開発・設備投資を継続

次に、「研究開発費と設備投資の計画」です。FY2025は、いずれも過去最高となる見通しで、前述のとおり、研究開発費は、2,530億円、設備投資、減価償却費はそれぞれ、1,700億円、630億円を見込んでおります。

FY2025 配当予想



- FY2020～2023の1株当たり配当額は、FY2020の期首に株式分割がおこなわれたと仮定した金額を記載しています。
- FY2023には60周年記念配当が含まれます。
- 株式分割がおこなわれる以前の金額を（ ）内で記載しています。

当社の株主還元策

連結配当性向：50%

但し、1株当たり年間配当金50円*を下回らない

2期連続して当期利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討する

自己株式の取得：機動的に実施を検討

*2023年4月1日付の株式分割により、従来の150円から変更しています。

2023年4月1日付で普通株式1株を3株に分割。通期配当は519円を予定

次に、「配当予想」についてです。今期の業績予想修正に基づき、1株当たりの配当は、通期で519円を予定しております。

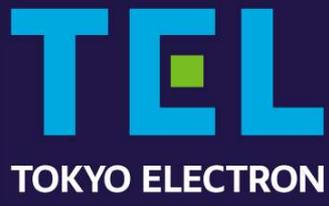
総還元額



自己株式取得と合わせ、過去最高レベルの総還元額を見込む

こちらは最後のスライド、「総還元額の推移」になります。今期の総還元額は、先程ご説明した1株あたり配当額と、自己株式取得を合わせ、3,198億円と、過去最高の総還元額になる見込みです。私からのご報告は以上となります。

ご清聴ありがとうございました。



本資料の取扱上の注意

当社の書面による承諾なしに複製、または
第三者への開示はできません。

東京エレクトロン

TEL および“TEL”は、東京エレクトロン株式会社の商標です。